

# 平成16年3月期 中間決算説明会

2003年10月29日

**沖電気工業株式会社**

<http://www.oki.com/jp>

## 【説明内容】

### 1. 2004/3期中間決算

中間決算概要

地震による影響

連結P/L(中間期、第2四半期)

連結B/S

### 2. 2004/3期通期業績予想

### 3. 構造改革の進捗状況ー成長フェーズへ

### 4. 2005/3期に向けて

- Q2は当初計画どおり営業黒字化達成。上期は前年同期比増収増益
- 東北地方の地震、光関連市況回復遅延によるデバイスセグメントの減収、減益
- デバイスセグメントの影響を情報、通信部門で挽回。前回公表(7/30)に対し良化
- 第3次構造改革を着実に推進中  
(事業構造改革、重点事業へのリソースシフト等)

(金額単位:億円 ※億円未満は四捨五入)

	当期実績	前期実績	増 減	前回公表(7/30)
売 上 高	2,813	2,506	307	2,650
営 業 利 益	△39	△106	67	△60
経 常 利 益	△82	△158	76	△110
当 期 利 益	△105	△115	10	△105
株 主 資 本	947	1,013 <sup>(注)</sup>	△66	—

(注) 03/3期末

- 二度にわたる東北地方での地震により、半導体生産子会社の宮城沖電気の操業が延べ20日間程度停止  
売上高・売上利益の減少、設備・仕掛り中ウェハの一部が損傷

## 【経緯】

- 5/26 三陸南地震発生  
(最大震度6弱)
- 6/06 三陸南地震被害をファイリング  
設備・棚卸廃棄損 6億円  
操業損 6億円 の合計12億円
- 7/26 宮城県北部地震発生  
(最大震度6強)
- 7/30 両地震の被害をファイリング  
特別損失 30億円  
今中間期の当期純利益予想を  
△85億円から△105億円へ  
修正

## 地震被害がPLに与える影響 (億円)

	上期	下期	年間
売上高	△40	△10	△50
営業利益	△25	△5	△30
特別損失	△31	—	△31

## ■ 比較中間連結P/L

(金額単位:億円)

	当中間期	前中間期	差異(増減)
<b>売上高</b>	<b>2,813</b>	<b>2,506</b>	<b>307</b>
(売上原価率)	(76.0%)	(77.6%)	(1.6%良化)
売上原価	2,137	1,944	193
販管費	715	668	47
<b>営業利益</b>	<b>△39</b>	<b>△106</b>	<b>67</b>
営業外収支	△43	△52	9
経常利益	△82	△158	76
特別利益	9	8	1
特別損失	(注1) 74	(注2) 35	39
税引前利益	△147	△185	38
法人税等	△42	△70	28
当期純利益	△105	△115	10

## 連結売上高

(億円)

	03/9期	02/9期	差異
情報	1,516	1,344	172
通信	445	378	67
デバイス	600	585	15
その他	252	199	53

## 連結営業損益

(億円)

	03/9期	02/9期	差異
情報	51	35	16
通信	△16	△71	55
デバイス	△21	△17	△4
その他	5	△2	7
本社・消去	△58	△51	△7

(注1) 災害損失 31億円、特別退職金16億円など

(注2) 事業再編損25億円、評価損5億円など

## 第2四半期の状況

## ■ 比較第2四半期連結P/L (金額単位:億円)

	当期Q2	前期Q2	差異(増減)
<b>売上高</b>	<b>1,695</b>	<b>1,536</b>	<b>159</b>
(売上原価率)	(73.2%)	(74.5%)	(1.3%良化)
売上原価	1,240	1,144	96
販管費	363	347	16
<b>営業利益</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
営業外収支	△33	△18	△15
経常利益	59	27	32
特別利益	9	5	4
特別損失	(注1) 59	(注2) 22	37
税引前利益	9	10	△1
法人税等	4	1	3
当期純利益	5	9	△4

## 連結売上高

(億円)

	03/Q2	02/Q2	差異
情報	940	838	102
通信	279	240	39
デバイス	328	330	△2
その他	148	128	20

## 連結営業損益

(億円)

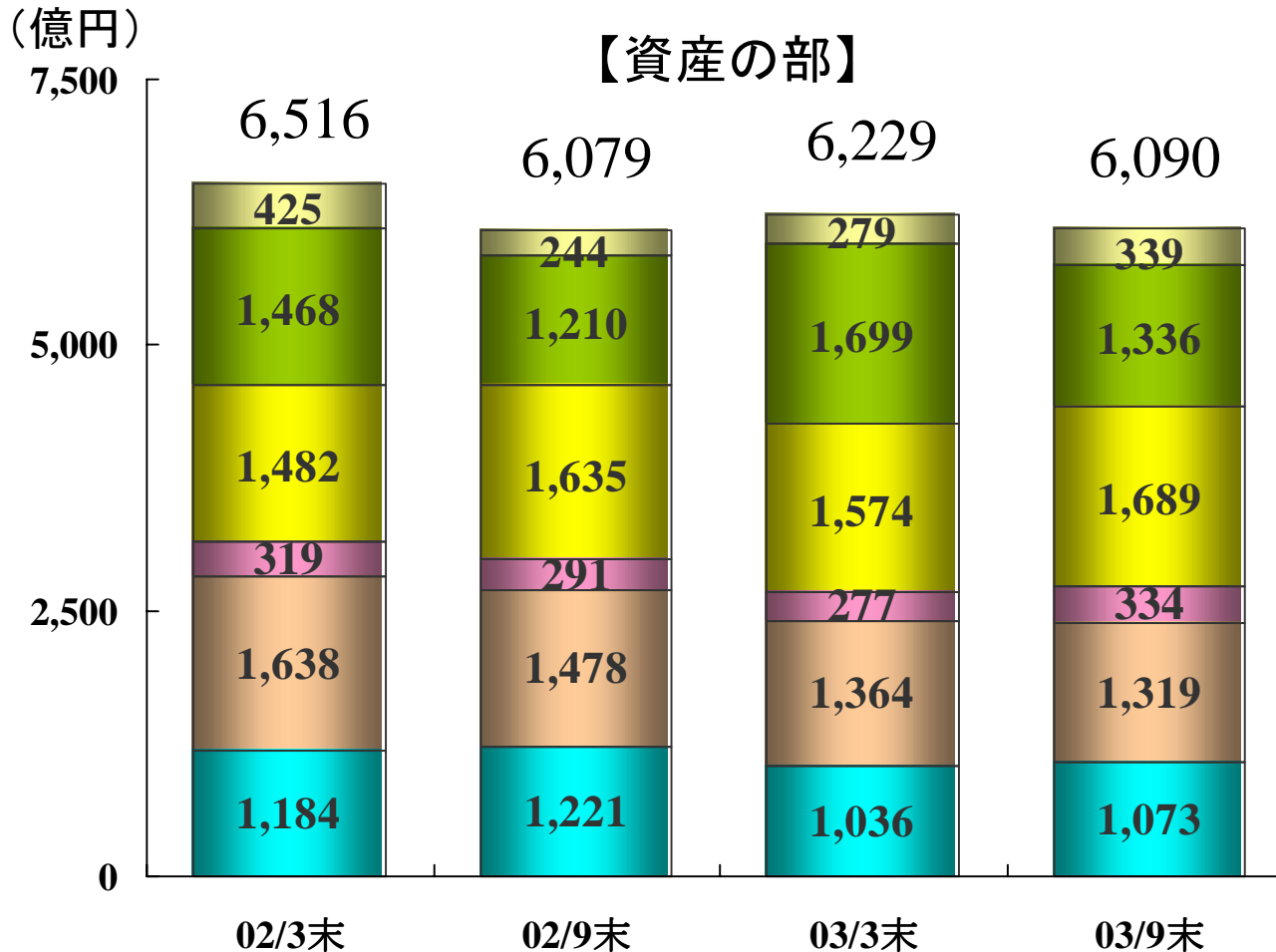
	03/Q2	02/Q2	差異
情報	77	73	4
通信	12	△39	51
デバイス	27	33	△6
その他	7	5	2
本社・消去	△31	△27	△4

(注1) 災害損失 31億円、特別退職金16億円など

(注2) 事業再編損15億円、評価損5億円など

- 棚卸資産は下期の生産準備のため増加したが回転率は前年同期比で良化
- キャッシュ・フローの改善により現預金増加
- 上場株式含み益は92億円増加(25→117)

回転率	02/上	03/上
総資産	0.8	0.9
売上債権	3.7	3.7
棚卸資産	3.2	3.5
有形固定	3.2	4.2

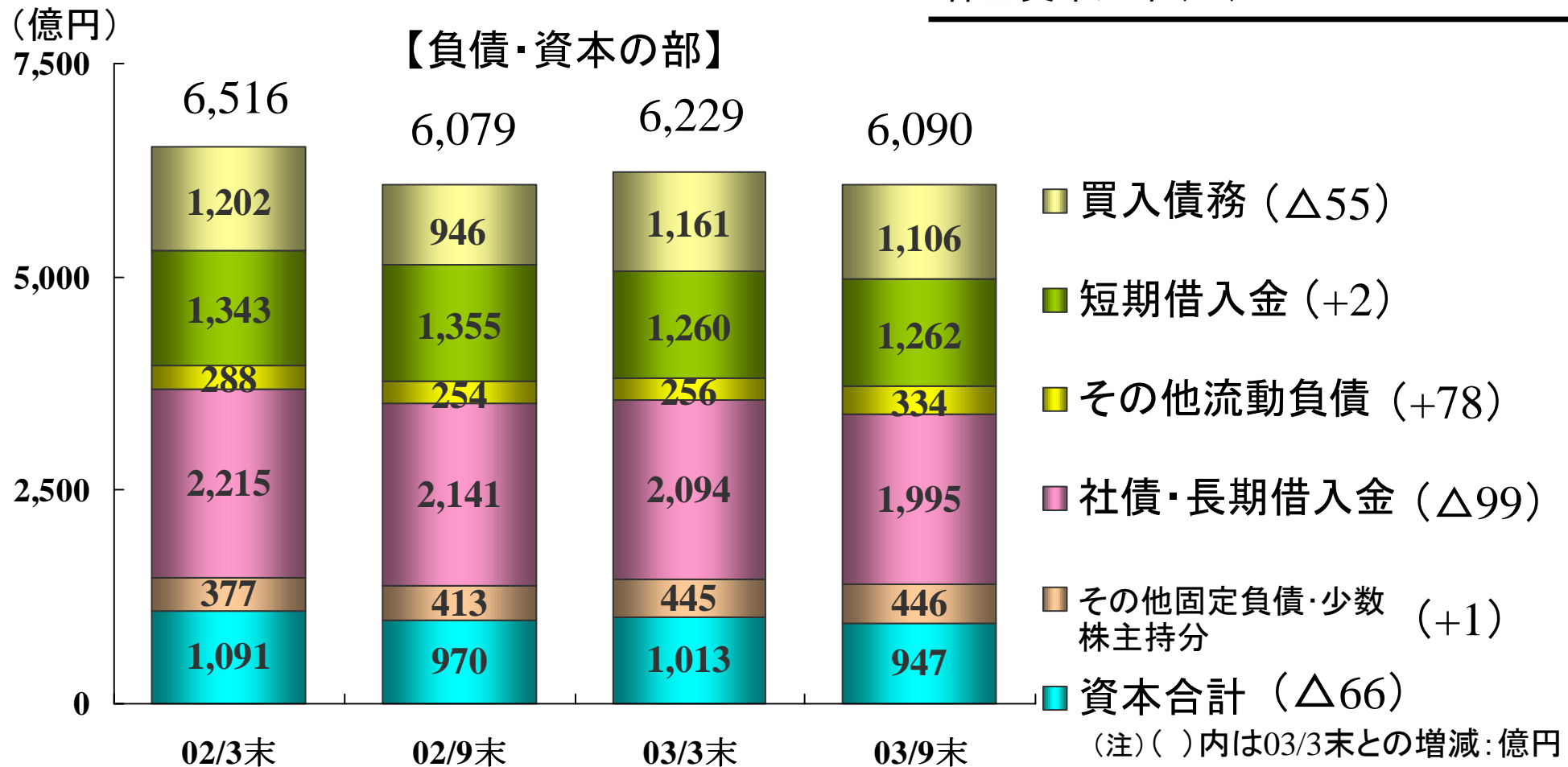


- 現預金 (+60)
- 売上債権 (△363)
- 棚卸資産 (+115)
- その他流動資産 (+57)
- 有形固定資産 (△45)
- その他固定資産 (+37)

(注) ( )内は03/3期末との増減:億円

■ キャッシュ・フローの改善努力により  
有利子負債は03/3末対比98億円減少、  
同比率は0.4%改善し53.5%

	03/3末	03/9末
有利子負債残(億円)	3,355	3,257
同上比率(%)	53.9	53.5
株主資本比率(%)	16.0	15.5



## 【説明内容】

### 1. 2004/3期中間決算

### 2. 2004/3期通期業績予想

事業環境と為替の想定

通期業績予想－売上高・営業利益・当期利益

営業利益増加要因

セグメント別売上高・営業利益

キャッシュ・フロー

設備投資・R&D

### 3. 構造改革の進捗状況－成長フェーズへ

### 4. 2005/3期に向けて

## 【経済見通し】

企業の業績改善に伴い、年度後半より民間設備投資は回復基調  
欧米に景気回復の兆候があるが、円高の進行に対する懸念あり

## 【市場動向】

- 情報 IT投資に回復感、新紙幣発行によりATM更新・改造需要堅調
- 通信 050サービス開始で通信キャリア・企業のIP電話関連の需要拡大
- デバイス 半導体市況は年初から堅調、民生・通信用LSIは活況、光関連不調

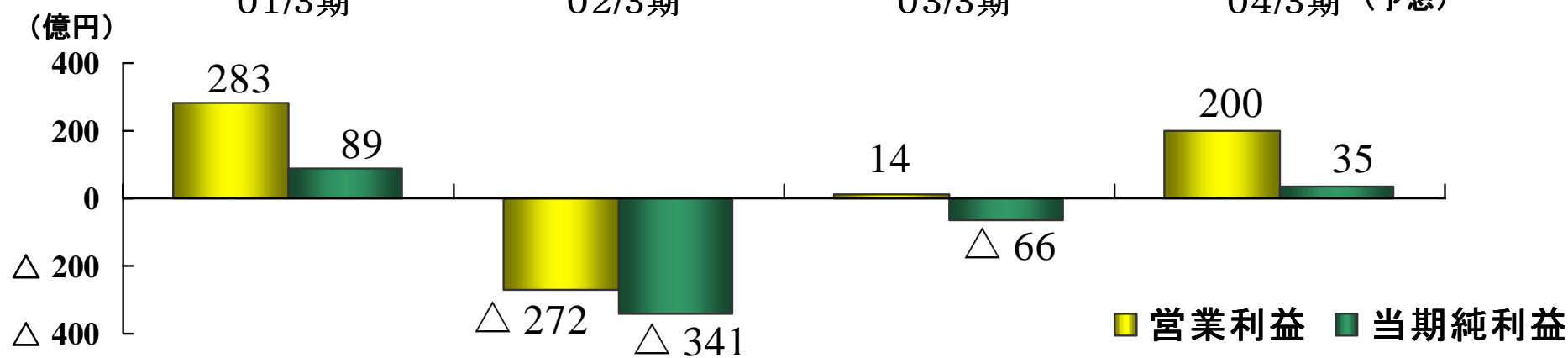
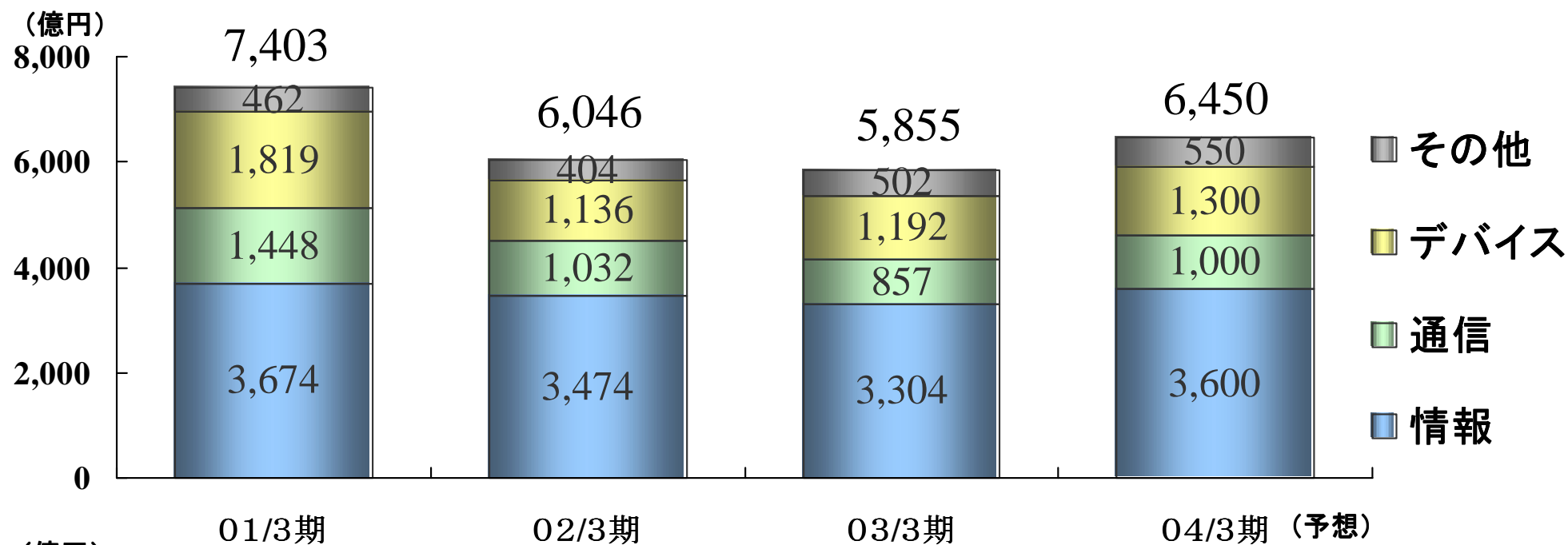
## 【為替レート的前提および損益に与える影響】

	中間期実績			下半期見込み		
	想定レート	実勢レート	外貨建売上 (億通貨)	想定レート	外貨建売上 (億通貨)	(注)1円変動による損益影響
USDドル	120円/\$	118.2円/\$	3.5	110円/\$	4.0	1億円
ユーロ	125円/E	133.6円/E	2.4	125円/E	3.0	1億円

(注)外貨建仕入、為替予約等控除後

# 2004/3期 通期業績予想

- 前年度対比で売上高は595億円の増加、営業利益は186億円改善
- 当初計画対比で売上高は150億円増加、地震の影響、価格競争激化、円高の進行により、利益は計画通り

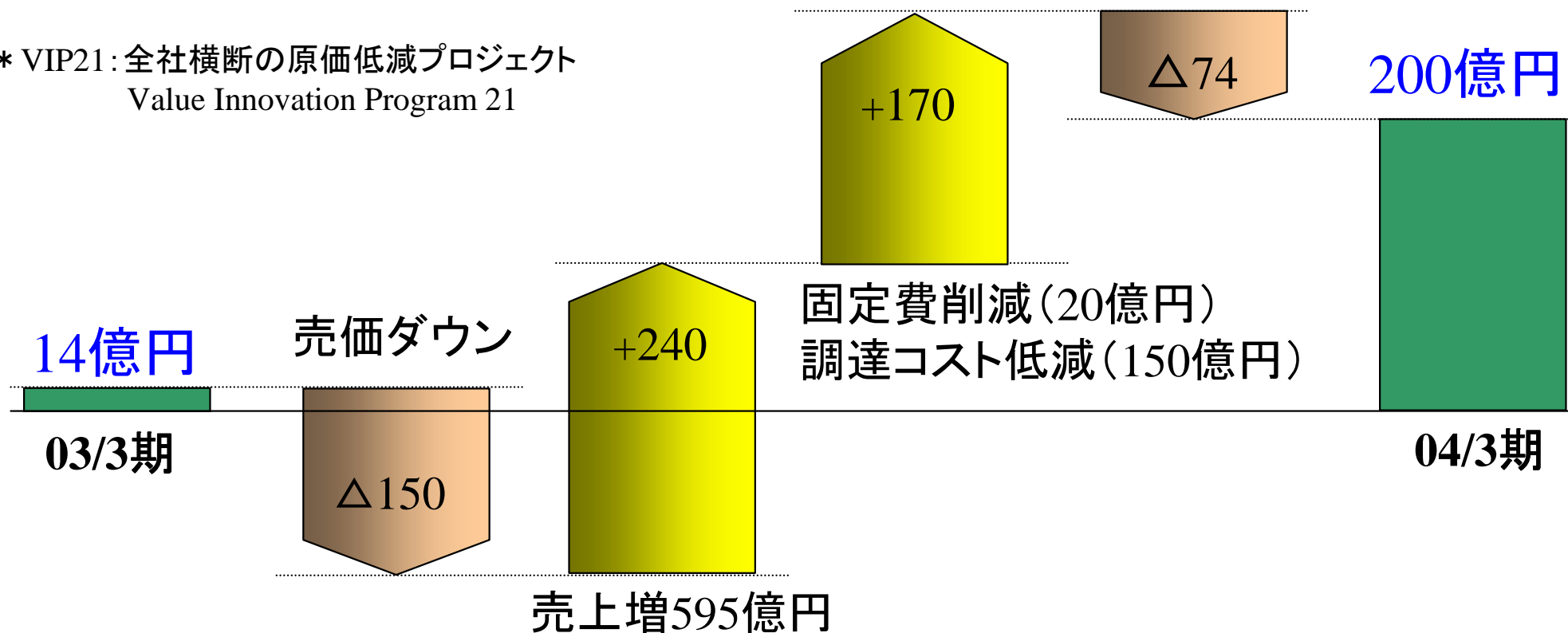


- 営業利益は前期比186億円増益見込み(14→200億円)
- 固定費は人件費を中心に20億円程度減少の見込み

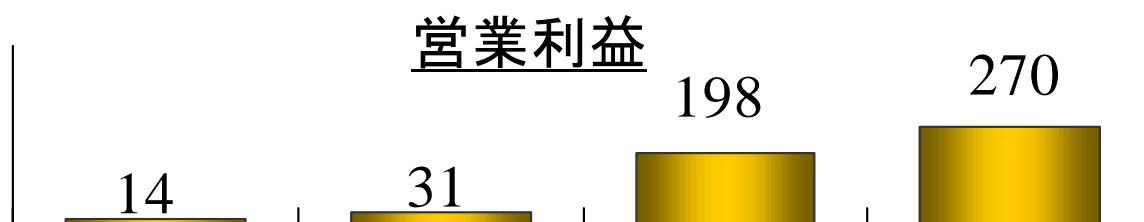
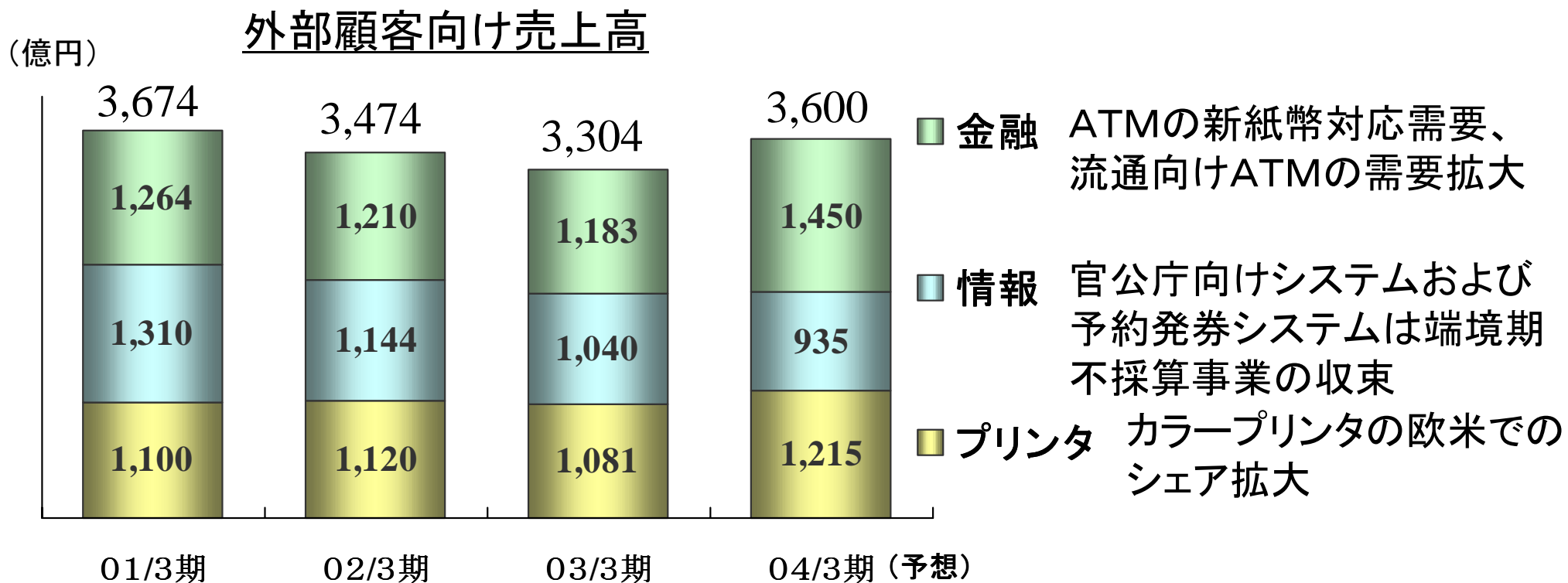
VIP21活動により  
調達コストを10%低減

地震の影響  
棚卸減少等

\* VIP21: 全社横断の原価低減プロジェクト  
Value Innovation Program 21



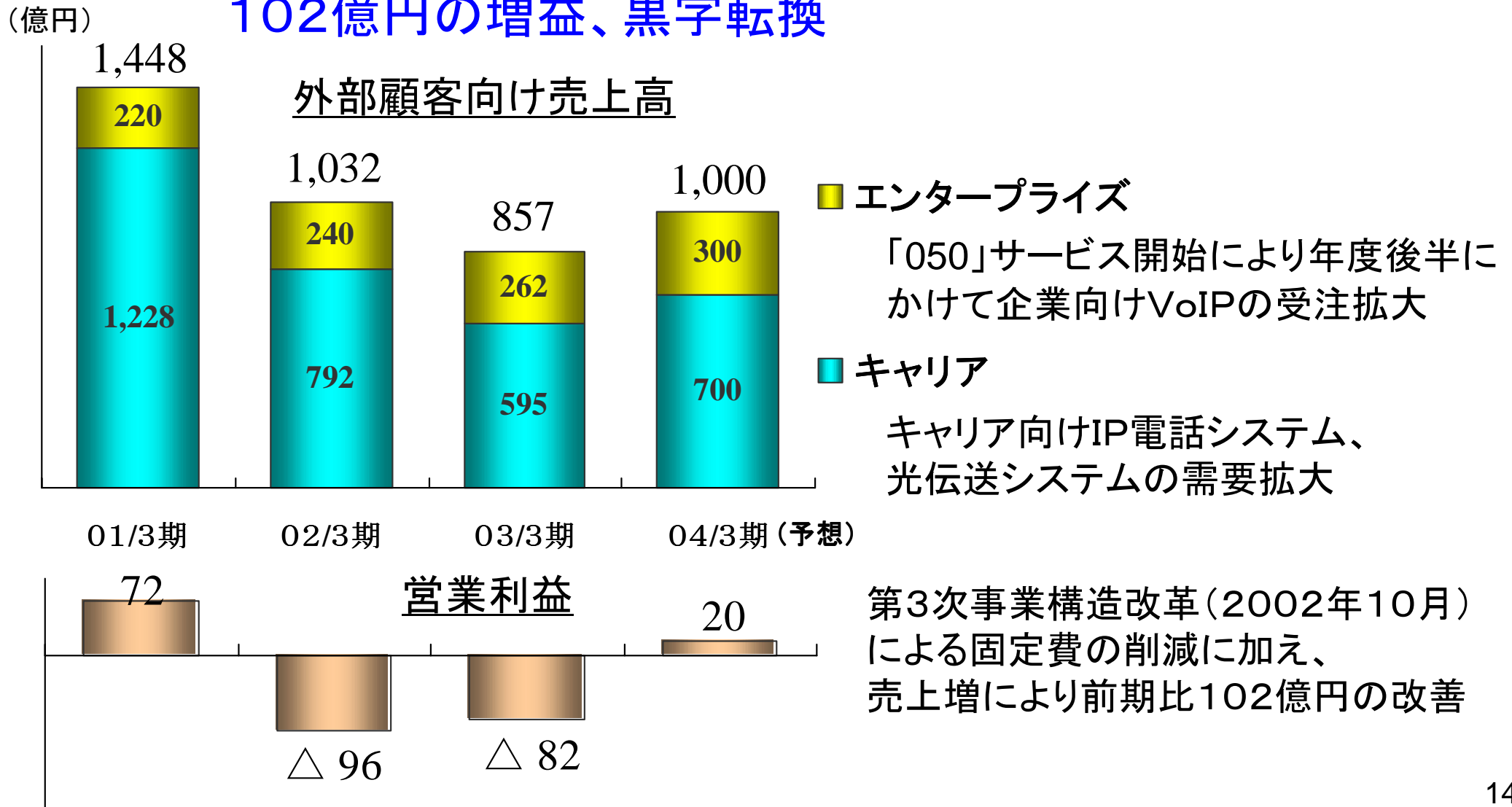
- 売上高は前期比296億円増収(当初計画対比150億円増)
- 営業利益は前期比72億円の増益(当初計画対比20億円増)



競争激化による価格下落、海外向けATMや新型プリンタの先行投資負担増により営業利益は72億円増の見込

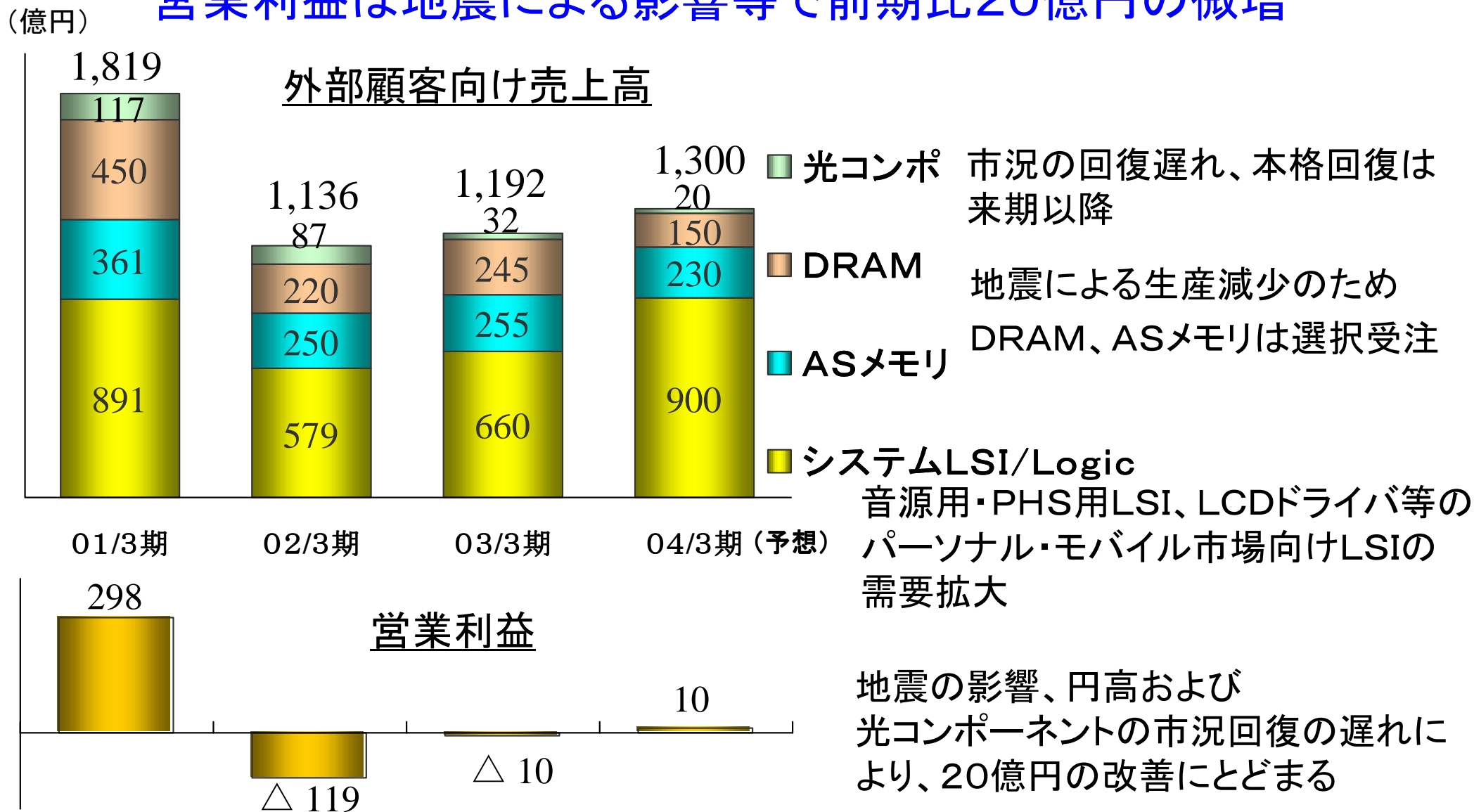
# 2004/3期予想【通信セグメント】

- 減収傾向に歯止め、売上高は前期比143億円増収
- 事業構造改革の成果により、営業利益は前期比102億円の増益、黒字転換



# 2004/3期予想【デバイスセグメント】

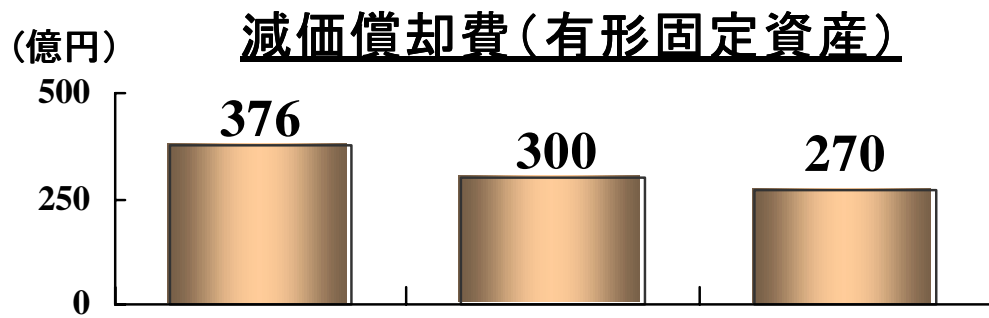
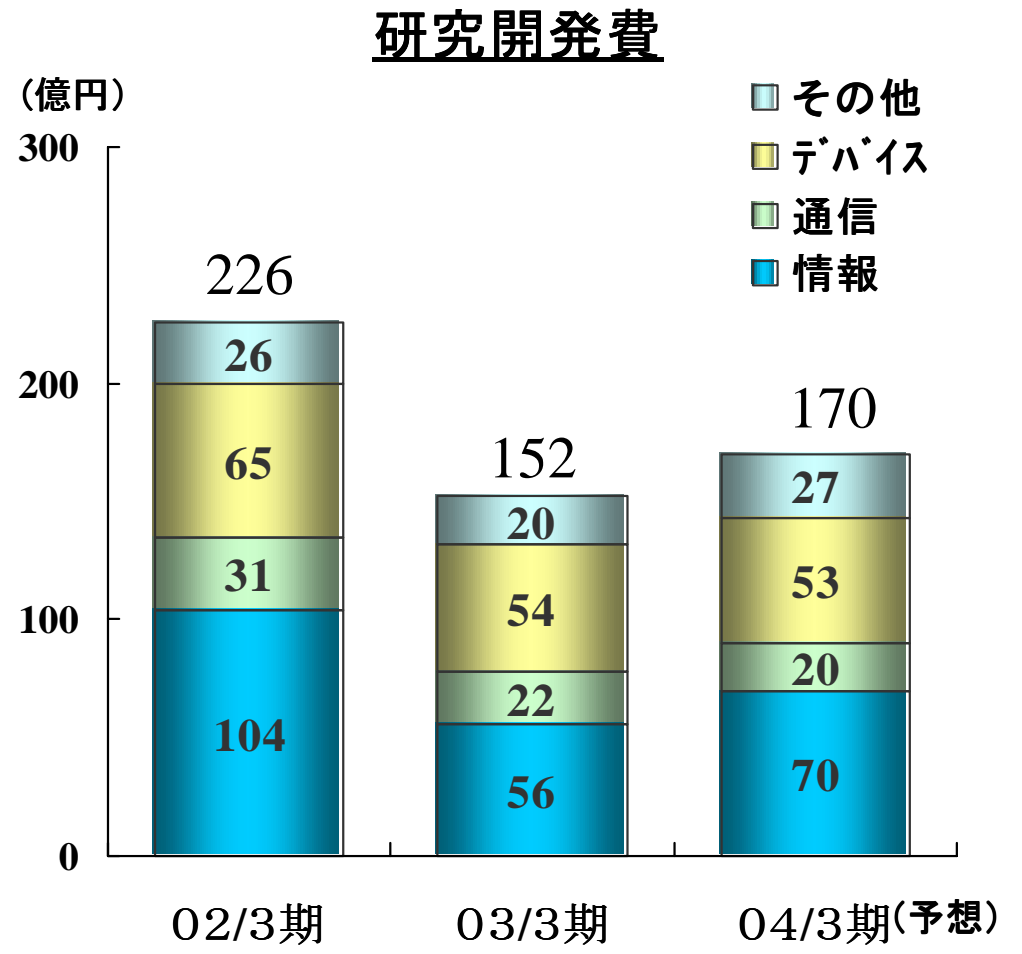
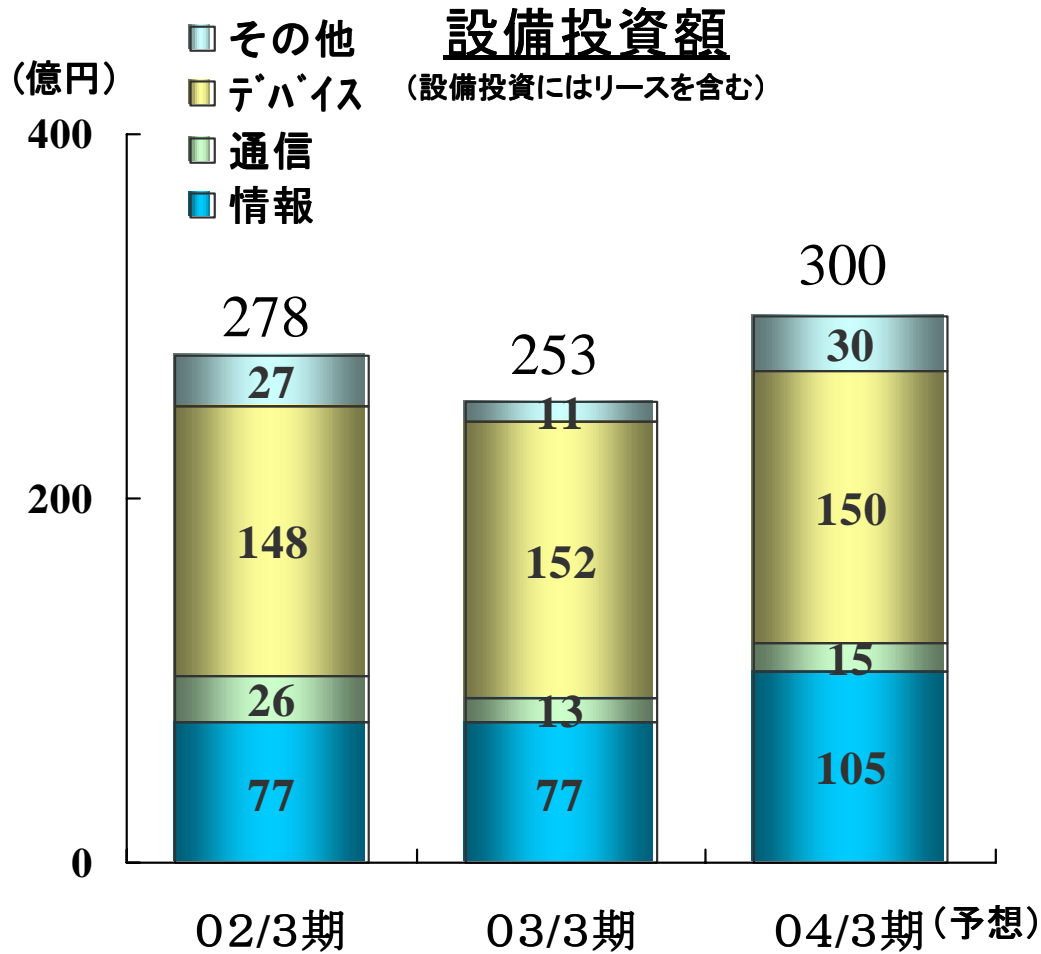
- 売上高は前期比108億円の増収  
営業利益は地震による影響等で前期比20億円の微増



## ■ キャッシュ・フローは中間期、通期とも大幅に改善

(金額単位:億円)	03/3期		04/3期		備考
	中間期	通期	中間期	通期	
営業CF	△ 90	2	271	800	① 売上債権回収(365) 棚卸資産増加(△126) ② 棚卸資産減少等 ③ 退職給付引当金他
税前当期純利益	△ 185	△ 35	△ 147	60	
減価償却費	200	399	168	370	
運転資金の増減	△ 116	△ 339	① 167	② 220	
その他	11	△ 23	83	③ 150	
投資CF	△ 44	43	△ 104	△ 350	④ ソフトウェアの取得等
設備投資支払額	△ 123	△ 236	△ 101	△ 200	
その他投資活動	79	279	△ 3	④ △ 150	
FCF( + )	△ 134	45	167	450	
財務CF	△ 60	△ 201	△ 93	△ 400	⑤ 社債償還 03/4: 77億円 04/3: 322億円
社債償還	△ 225	△ 227	△ 77	⑤ △ 399	
長短借入金増減	165	26	△ 16	△ 1	
CF計( + + )	△ 194	△ 156	74	50	
現金同等物等残高	255	293	363	343	

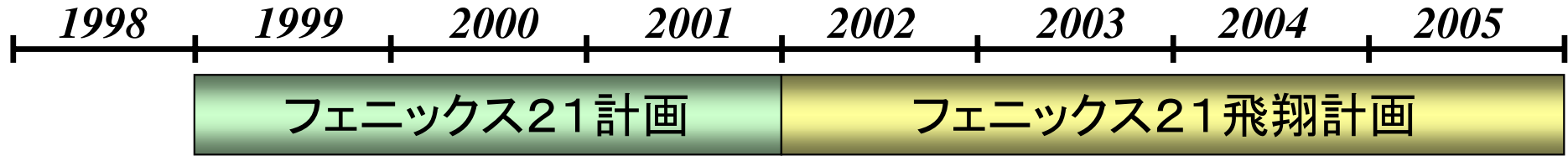
# 2004/3期 設備投資・R&D



- ◆ 重点事業分野の研究テーマに特化、効率化
- ◆ アライアンスを活用した商品開発を強化

## 【説明内容】

1. 2004/3期中間決算
2. 2004/3期通期業績予想
3. 構造改革の進捗状況－成長フェーズへ  
第3次構造改革の進捗状況  
情報・通信融合ソリューション  
金融ソリューション事業  
プリンタ事業  
特色あるLSI事業の展開  
光コンポーネント事業の再構築
4. 2005/3期に向けて



▲ 1998.9  
第1次構造改革

▲ 2001.8  
第2次構造改革

▲ 2002.10  
第3次構造改革

第3次構造改革の主要項目	進捗状況
<b>事業構造の再構築</b> 通信事業 光コンポーネント事業 生産サービスカンパニー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通信、生産サービス事業の再構築(収益化)は完了し、成長フェーズへ</li> <li>● 光コンポーネント事業の再構築は進行中</li> </ul>
<b>緊急避難策の実施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人員スリム化・固定費削減は今期も予定通り進行</li> </ul>
<b>情報通信融合事業強化</b> BB/IPネットワーク事業 金融ソリューション事業 NW関連ソフト・サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VoIPを核にいい音(e音)とAP@PLATで次なるステージへ</li> <li>● 金融の新サービス拡充および事務コスト削減に寄与する各種バックヤードシステムのシェアアップ</li> <li>● 中国向けATMの開発・投入</li> </ul>
<b>半導体事業の再構築</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システムLSIを中心に特色あるLSIに注力</li> </ul>

# 情報・通信融合第1幕：市場基盤の確立

**【第1幕】 VoIP技術を核にして、業界・技術を先導し、情報・通信融合市場を切り拓き、市場基盤を確立**

- ・VoIP市場： 国内シェアNo.1(40%)
- ・コールセンタ市場： 国内シェアNo.1(31%)
- ・映像配信システム市場： 国内シェアNo.1
- ・世界最大ソフトスイッチ稼働実績
- ・NECと企業通信システム関連のアライアンス
- ・IPTPCによる業界牽引、普及活動
- ・Webアプリケーション連携SIPソフトスイッチなどの技術開発



ブロードバンド/モバイル時代到来で  
VoIP/映像配信/CTIの顧客価値増大

**第1幕：市場基盤の確立**

VoIP/映像配信/CTIで  
新市場をインキュベート



音声/映像/データ統合NW構築技術を確立し  
情報、通信技術者融合、商品開発力強化  
お客様に最適なソリューションを提供



# 情報・通信融合第2幕：利活用の加速

【第1幕】で築いた技術・ノウハウ・実績をベースに  
ブロードバンド時代の新たなステージ【第2幕】を展開

継続した技術革新を先導  
コア商品の機能拡張

- ・VoIP市場： 成長率60%市場にて国内シェアNo.1維持
- ・コールセンタ市場： 売上高30%/年アップにて国内シェアNo.1維持
- ・映像配信システム市場： 国内シェアNo.1の維持

## 第2幕：利活用の加速

ユビキタス/モバイル  
の進展を加速し  
更なる利便性を実現

「いい音(e音)」と「AP@PLAT」  
で新しい価値を提供

幅広い商品・サービスと安心の  
提供により顧客期待に応える



「用件をただ伝える」から、  
「雰囲気も伝える」  
豊かなコミュニケーションを  
「いい音(e音)」で実現

音声/映像/データ統合  
セキュリティ、決済機能強化  
により安心と安全を実現

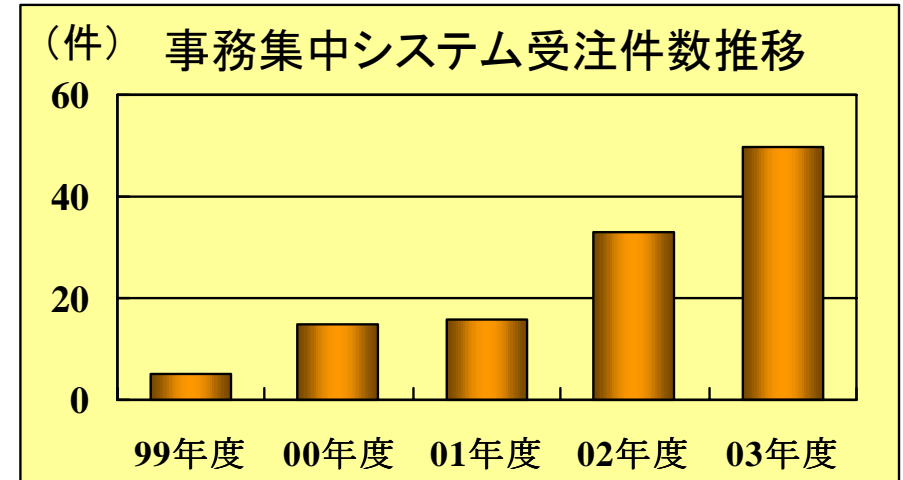
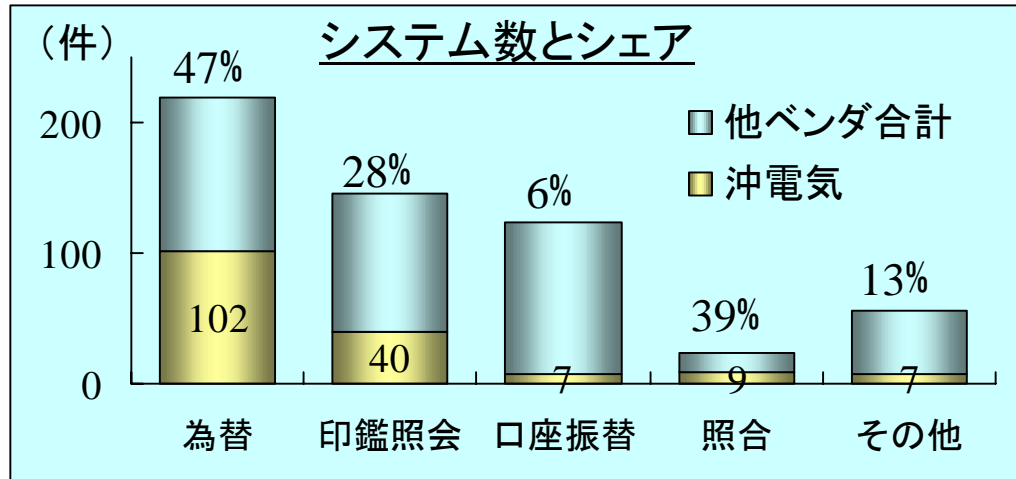
多様化する利活用に迅速対応  
Webとテレコミュニケーションを  
融合した新たなIT付加価値を  
「AP@PLAT」で実現

金融機関のITシステム投資は、新紙幣対応の終了とともに、競争力、収益力の強化・拡大を目的として行われる「更なる事務コストの削減」と「新サービスの拡充」へ

視点	代表的な取り組み	沖のソリューション
顧客	リレーションシップ・バンキング	ChannelNavigator
	チャネル連携	統合コンタクトセンタソリューション
チャネル	チャネルサービスの充実化	無人相談・契約機
	軽量化・後方レス化	統合事務集中ソリューション
	異業種連携	サプライチャネル連携ソリューション
商品	金融商品の拡大	セキュアゲートウェイ
	フィービジネス(宣伝広告等)	コンサルステーション
	ローン拡販	
	窓販(保険、投信、401K)	

# 事務集中システムと海外ATMの展開

- 金融機関の事務コスト削減に対応し事務集中システムの売上拡大  
一 為替、印鑑照合等の事務集中システムでトップシェア(29%)



- 中国市場専用の新型ATMを投入

2005年度にATMの出荷台数シェアの30%を獲得する

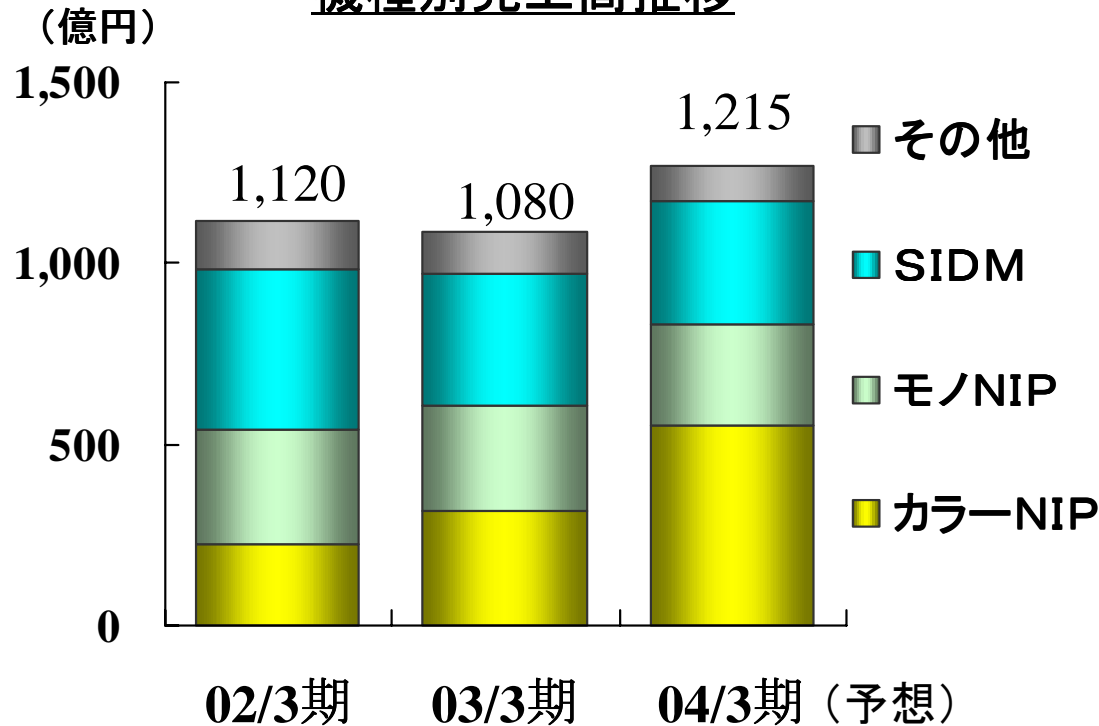
- 量産出荷時期 : 04年3月(現在商用トライアル中)
- 対象顧客 : 国有銀行、都市商業銀行



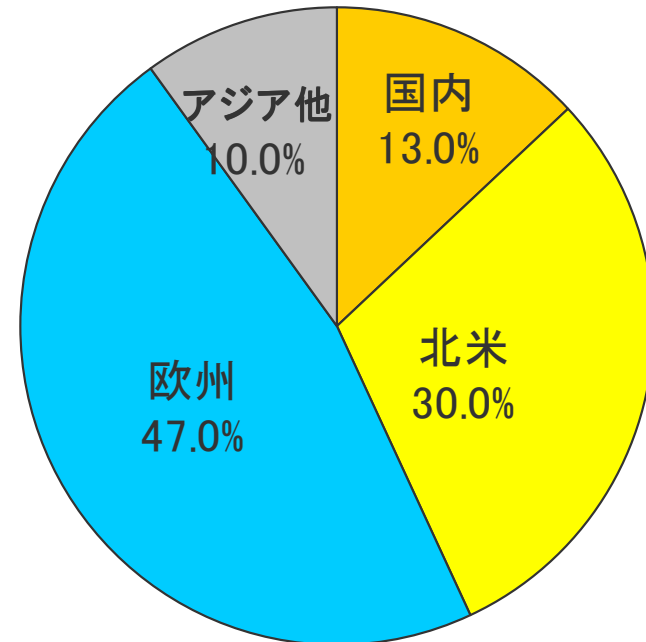
高機能・堅牢・コンパクトな  
中国市場向け新型ATM

- LED光源方式による高速カラー印刷の優位性を生かし  
欧米のカラープリンタの販売シェア急増  
 西欧:02年/10-12月;6位(5%)→03年/4-6月;2位(16%)  
 北米:02年/10-12月;8位(3%)→03年/4-6月;4位(5%)

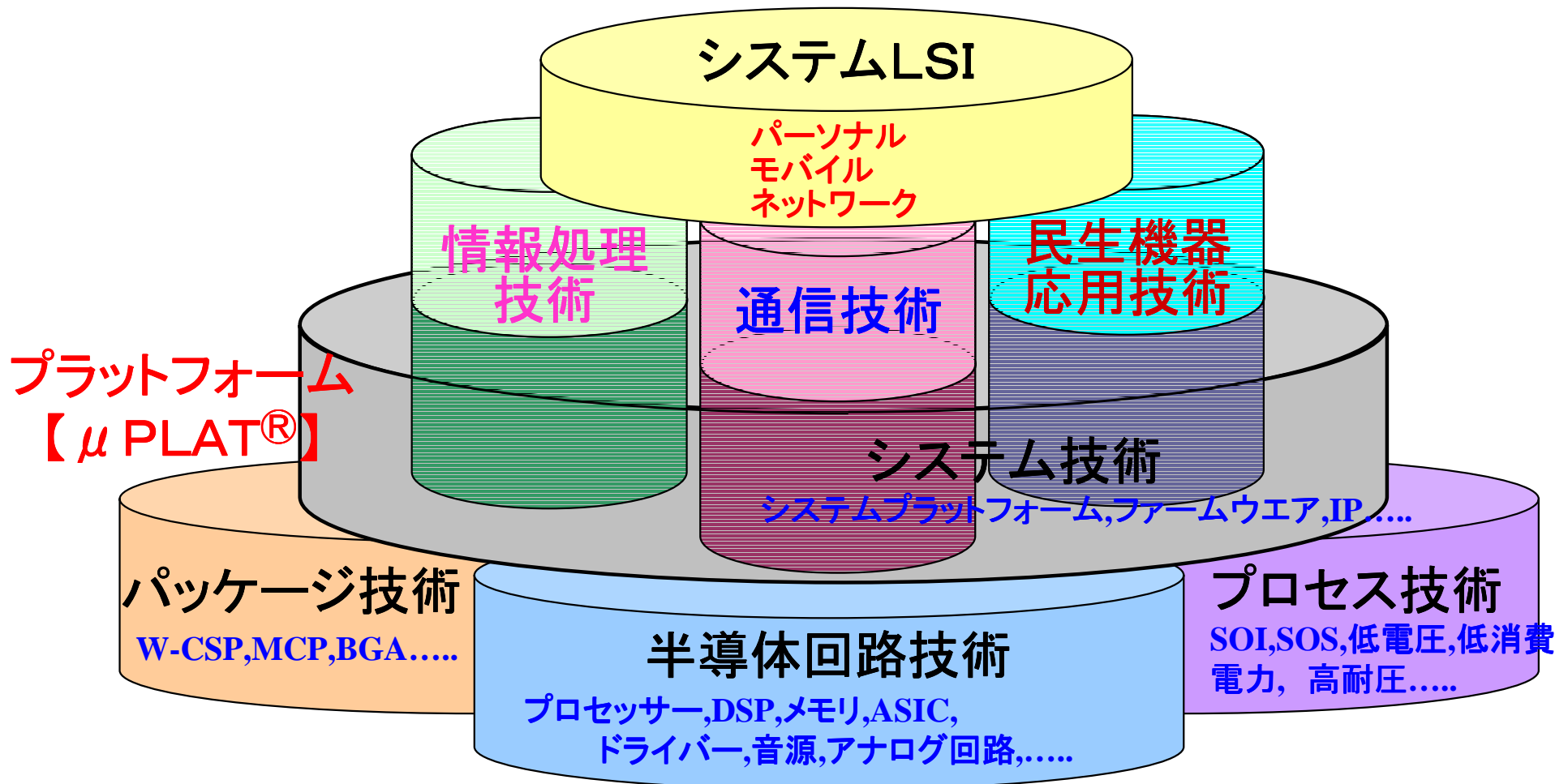
機種別売上高推移



市場別売上高比率  
(2004/3期予想)



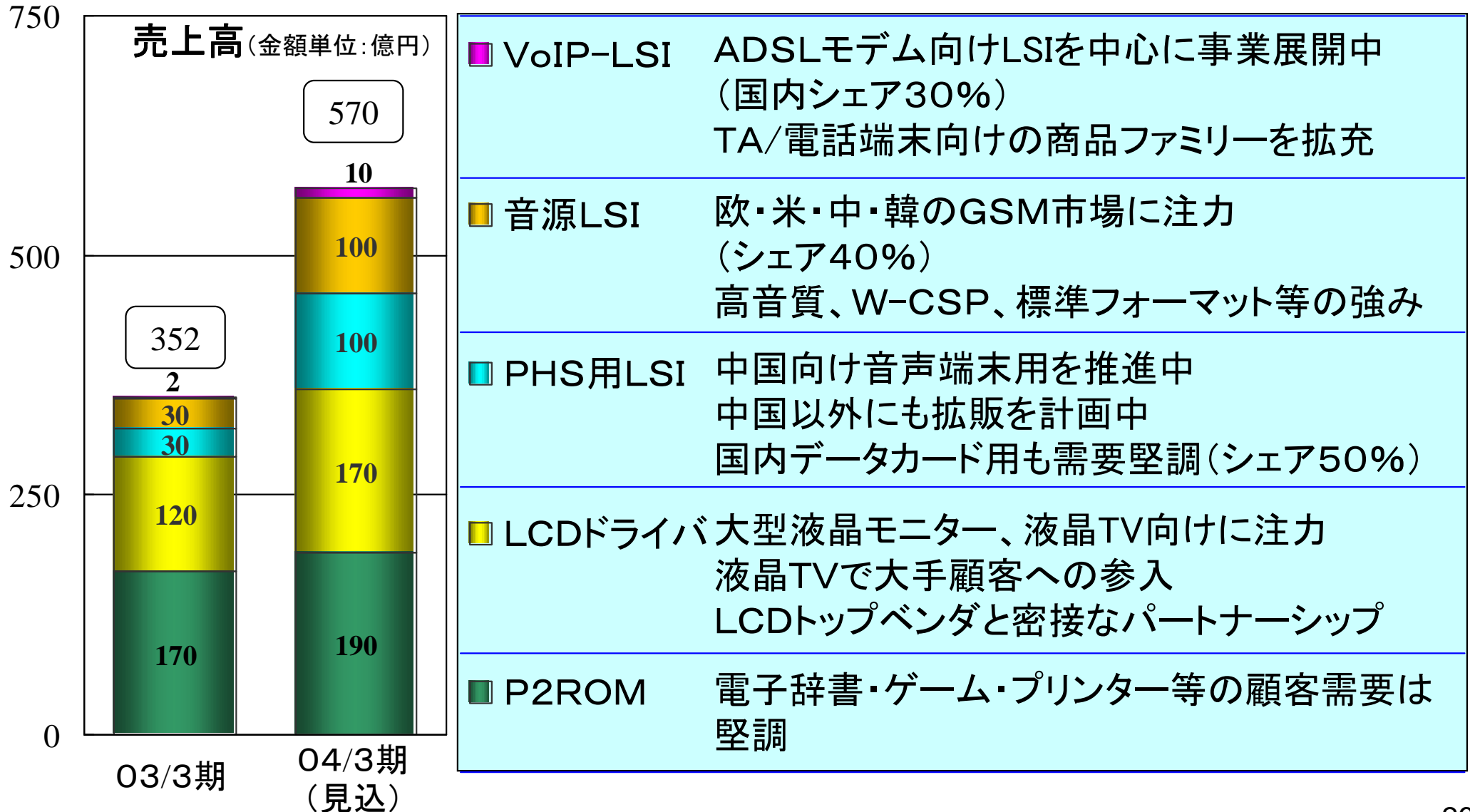
- ARMコアの  $\mu$ PLAT<sup>®</sup>を核にパーソナル、モバイル、ネットワークの各分野を当社の注力分野と定め、システムLSI事業を拡大中



# 注力LSIの事業動向

## 沖の特色あるLSI群のトレンド

## 事業動向

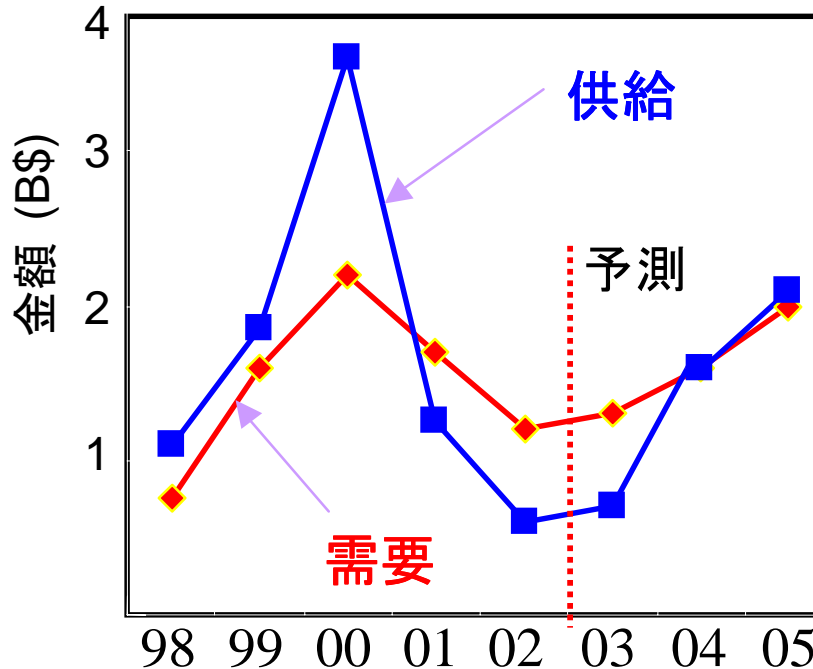


- 市場在庫の調整は今年度中に終わり、来期以降は適正水準へ
- 今年度末以降、光通信デバイス市場は需給バランス均衡の見込み

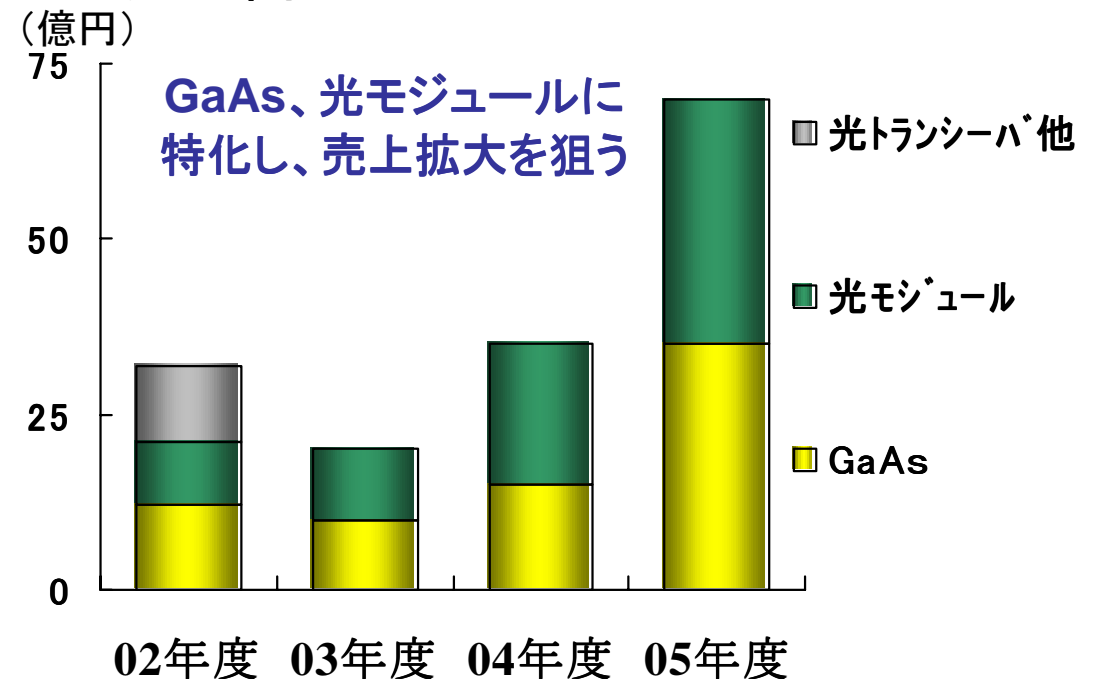
## 【 施策 】

- GaAs素子、レーザーダイオード等の光部品事業に特化
- 光トランシーバ事業をフジクラ殿との合併会社シグマリンクスへ移管(03/4)
- 人員削減、投資抑制、外部リソース活用(\*NELとの生産統合等)
- 来期以降の市場回復に向けた運営体制整備、新商品の創出力強化

### ◆ 光部品市場の需給バランス



### ◆ 売上高計画



## 2005/3期に向けて

- 来期も市場環境は回復基調の継続が予測される  
従って、売上高増加は十分期待できる  
第三次構造改革の着実な推進により、事業の高付加価値化、  
コスト低減等により、更なる収益増大を目指す

情報 : 金融ITソリューションの積極展開  
官公庁市場の大型システムの受注  
カラープリンタシェア拡大

通信 : IP電話市場の本格的拡大への積極対応

デバイス : 市況の本格的回復、第三次構造改革の加速  
パーソナル、モバイル、ネットワーク市場展開へ注力

- 新紙幣発行日に向けての万全な体制構築
- 注力事業分野への投資および有利子負債圧縮を目指し  
更なるキャッシュ・フローの創出
- 利益の増大による株主資本の充実

## 略語説明

P10.	IT	Information Technology
	ATM	Automated Teller Machine
	IP	Internet Protocol
	LSI	Large Scale Integrated circuit
P14.	VoIP	Voice over Internet Protocol
P15.	DRAM	Dynamic Random Access Memory
	AS	Application Specific
	PHS	Personal Handyphone System
	LCD	Liquid Crystal Display
P16.	CF	Cash Flow
	FCF	Free Cash Flow
P19.	BB	Broadband
	NW	Network
P20.	CTI	Computer Telephony Integration
P24.	LED	Light-Emitting Diode
	SIDM	Serial Impact Dot Matrix
	NIP	Non-Impact Printer
P25.	IP	Intellectual Property
	W-CSP	Wafer level Chip Size Package
	MCP	Multi Chip Package
	BGA	Ball Grid Array
	DSP	Digital Signal Processor
	ASIC	Application Specific Integrated Circuit
	SOI	Silicon on Insulator
	SOS	Silicon on Sapphire
P26.	ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
	TA	Terminal adapter
	GSM	Global System for Mobile Communications
	P2ROM	Production Programmed Read Only Memory
P27.	GaAs	Gallium Arsenide

※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。